公司代码:688519　　公司简称:南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.ccl-china.com/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 (含税)。截至 2023 年 3 月 9 日,公司总股本 234,751,600.00 股,扣除回购专用证券账户中股份总数 8,555,434.00 股后的股本 226,196,166.00 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 56,549,041.50 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 125.99%。

根据《上市公司股份回购规则》规定,“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 216,003,544.53 元 (不含交易费用),占归属于上市公司股东的净利润比例为 481.24%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因新增股份上市、回购股份等事项发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。该利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所科创板	南亚新材	688519		

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张柳	郑小芳
办公地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号
电话	021-69178431	021-69178431
电子信箱	nanya@ccl-china.com	nanya@ccl-china.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。覆铜板是制作印制电路板的核心材料,印制电路板是电子元器件电气连接的载体。覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件,被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。

2、主要产品及服务情况

公司主要产品为覆铜板及粘结片,具体如下:

(1)覆铜板

覆铜板(Copper Clad Laminate,简称 CCL)全称为覆铜箔层压板,是将增强材料浸以树脂胶液,一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,是制作印制电路板的核心材料。覆铜板担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。

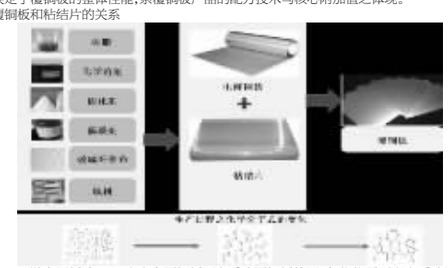
由于下游应用领域众多且性能需求各有差异,公司的产品明细规格繁多,按照胶系 (树脂配方体系)大致可以分类为普通 FR-4、无铅兼容型 FR-4(以下简称“无铅板”)、无卤无铅兼容型 FR-4(以下简称“无卤板”)、HDI、高频高速、能源及 IC 载板材料等。具体情况如下所示:

类别	代表型号	终端应用领域
普通板系列	NY1140,NY1600	家电、电视、电脑、游戏机等
无铅板系列	NY2140,NY2150,NY2150H,NY2170,NY2170H,NY2600	手机、电脑、仪表仪器、汽车电子等
无卤板系列	NY3150HF,NY3150HC,NY3170HF,NY3170HC	智能终端,笔记本电脑、硬盘、内存、服务器、汽车电子等
高频高速板系列	NOUYA2G+,NOUYA4G+,NOUYA6,NOUYA6G,NOUYA7,NOUYA7+,NOUYA8,NOUYA-L (LOW CTE),NYHP-5L,NYHP-30,NYHP-5F,NYHP-5F+,NYHP-6A,NYHP-MW,NYP-55,NYHP-65,NYHP-3A	核心网、承载网、核心路由、交换机、服务器、光模块、TRx、数据中心、天线、功放、雷达等
车用板系列	NY-A1,NY-A2,NY-A3HF,NY-A5HF	汽车电子、充电桩等
能源板系列	NY2150H,NY3150HC,NY2170H	光伏、二次电源等
HDI板系列	NY3150HFLC,NY3150HF,NY3170HF、NY3170M,NY3170LK,NY3188HF,NY3198HF	手机、平板电脑,SSD,Ultra book、ETC 等
IC封装基材系列	NY-6IC,NY-8BIC,NY-8SIC,NY-8CIC	射频模组、手机、硬盘、内存、CPU、GPU 等

(2)粘结片

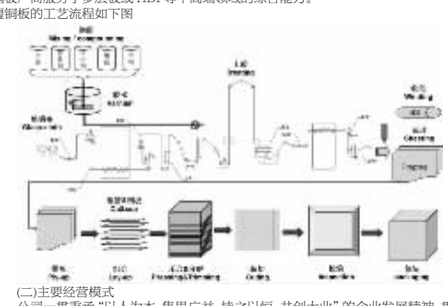
粘结片(Prepreg,简称 PP)又称半固化片,系覆铜板生产过程中的前道产品,粘结片在较大程度上决定了覆铜板的整体性能,系覆铜板产品的配方技术与核心附加值之体现。

覆铜板和粘结片的关系



下游多层板或 HDI 客户向覆铜板厂商采购覆铜板的同时,往往需要配套采购同厂商同规格的粘结片产品,用其作为多层板或 HDI 层与层之间的粘结和绝缘材料。粘结片的销售情况能很好地反映出覆铜板厂商服务于多层板或 HDI 等中高端领域的综合能力。

覆铜板的工艺流程如下图



(二)主要经营模式

公司一贯秉承“以人为本、集思广益、持之以恒、共创大业”的企业发展精神,贯彻“市场导向、管理创新、质量至上、技术领先”的经营方针,科学管理、不断创新、稳健发展。公司紧跟行业及市场的发展趋势与需求,始终致力于“成为全球领先的 CCL 行业制造与方案解决公司”,通过执行严格的质量标准,采取系统的质量控制体系和落实有效管理措施,为全球客户提供绿色、安全、环保的产品以及优质的售前、售中和售后服务。

公司产品通过了 CQC 产品认证、德国 VDE 产品认证、日本 JET 产品认证、美国 UL 安全认证。公司采取系统的质量控制体系,先后通过了 IATF16949 质量管理体系认证、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证、QC080000 危害物质过程管理体系。

公司凭借多年的技术积累和品牌建设,已建立了集研发、生产、销售、服务等方面的综合性优势,在市场中形成了较高的知名度和良好的美誉度。公司已与奥士康、方正科技、广东骏亚、沪电股份、瀚宇博德、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、深南电路、生益电子等知名 PCB 厂商建立了长期良好的合作关系。被深南电路、健鼎科技等评为“优秀供应商”。

1、研发模式

公司根据行业技术发展动态并结合市场调研结果,制定研发项目计划并向研发中心下达研发任务,评审立项后进入新产品的配方开发、内部测试、打样测试、量化转产、配方持续优化等阶段。产品研发主要以产品配方优化升级和新产品开发为主。

1)产品配方优化升级主要考虑成本优化和性能升级。公司根据市场变化及客户需求,对成熟产品原有配方技术进行更新升级达到成本优化或性能升级或两者兼具,以满足客户需求,增强市场竞争力。

2)新产品开发主要为公司战略研发产品的开发或头部终端技术合作的新品开发。由公司根据中长期战略目标或头部终端新品技术合作需求明确研发方向后,由研发中心组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,调研分析后提交公司审批立项。其中,项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。

2、采购模式

公司生产所需的原材料主要为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等。公司高度重视原材料供应体系建设,已建立合格的供应商评价体系,通过与上游知名供应商建立稳定的战略合作关系,保证原材料供应的稳定。公司采购部门负责定期询价,根据原材料需求计划,综合考虑交期因素,在询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同。

3、生产模式

公司实行“以销定产及需求预测相结合”的生产模式。公司以市场需求为导向,根据已接订单、销售预测、经营目标的情况制定生产计划。生产部门根据生产计划严格按照工艺标准组织生产,按时、保质、保量的提供满足客户需求的产品。在质量控制体系上,公司实行全面质量管理,全员共同参与并贯穿于设计到制造的全过程。

4、销售模式

公司坚持以客户为中心,“持续为客户创造更大的价值”,实现客户与公司可持续性共赢发展。产品销售以直销为主,以终端(OEM/ODM)及 PCB 客户需求为方向,持续扩大市场品牌影响及市场份额为目标,积极主动开发各领域内客户及新项目,采取“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”销售策略。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业发展阶段及其基本特点

(1)产业政策支持,发展前景明朗

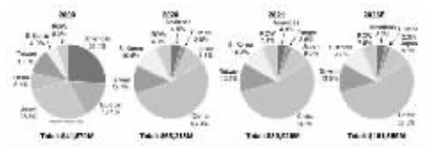
公司所属行业根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。

信息技术产业是关系国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,也是世界主要国家高度重视、全力布局的竞争高地。电子专用材料是支撑信息技术产业发展的基石,是保障产业链、供应链安全稳定的关键。电子专用材料行业发展不充分,将导致其下游产业如高性能高精密线路板、芯片封装、半导体等密切相关的 5G 通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域须依赖进口原材料,形成“卡脖子”困境。所以电子专用材料行业与信息技术产业互相促进,不可分割,具有广阔的发展前景。近年来,国家颁布了一系列政策法规,将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一,大力支持其发展。

(2)电子信息产业迁移,国内供应链成熟

本世纪以来,随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移,目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国和欧洲等区域。作为 PCB 产业上游,全球覆铜板制造企业主要分布也基本符合这个趋势。据 Prismark 统计,2000 年大陆 PCB 的全球市场占有率从 8.1%上升至 2021 年 54.6%,其中美国、日本、韩国在半导体领域保持竞争优势,中国台湾在芯片代加工方面保持全球领先,中国大陆在 PCB 行业,原材料领域已经崛起,中国大陆电子制造业充分受益于全球化之下的国际分工转移,凭借招商政策,人口红利与成本优势,成为电子产业链的世界工厂,在这个发展过程中,中国积累了其他国家短期难以复制的大量技术人才和高效的供应链体系。据 Prismark 资料显示,到 2026 年,全球 PCB 产值预计将达到 1,015.59 亿美元。

PCB 产值根据地区分布



资料来源:Prismark。

(3)新业态蓬勃发展,市场需求进入新发展

覆铜板的终端应用几乎涉及所有的电子产品。随着 5G 技术、云计算、数据中心、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展,给覆铜板产业带来了全新的发展机遇,也提出了更高的要求和标准。现阶段,市场需求主要体现在以下几个方面:

1、高速高频产品应用扩大,低损耗、高速传输成为主流,且该类产品及其原材料的国产化需求迫切,稳定且优质的供应链成为重中之重;

2、汽车电子电动化、智能化成为大趋势,带动了汽车板的快速增长;

3、载板及类载板材料需求量急剧攀升;

4、轻薄化、无卤化且低损耗,低涨缩材料成为常态需求。

国内领先的覆铜板同行纷纷已进入质、量、价三方面并重发展的新阶段,针对不同等级产品进行差异化布局。

2、主要技术门槛

覆铜板的终端应用广泛而复杂,且下游技术更新换代不断加快,故对覆铜板企业的综合技术创新能力要求较高,而其研发及制造技术又是一项多学科相互交叉、相互渗透、相互促进的高新技术,是一个复杂的系统工程。随着行业技术的不断升级换代,覆铜板企业不仅需要全面掌握并提升生产工艺,把控好品质的同时降低成本,确保生产出价优质好的产品,更需要应对终端不断提升的技术新需求研发创新出适用于市场的新品。

覆铜板的配方技术、生产工艺、品质控制均极其复杂。其中,配方技术是覆铜板企业最主要的技术,基本体现覆铜板的核心性能,是本行业最大的技术门槛。其难点在于如何从数以千计的高分子化合物中筛选适配原材料构建最佳反应配比组合,以实现产品在物理性能、化学性能、介电性能、环境性能等方面的最佳表现,另外还需考虑成本、性价比因素以满足量产和大规模应用需求。随着科技的进步及终端市场的需求变化,不具备一定技术实力、缺乏技术储备及行业经验的企业将无法适应技术与市场的快速发展。

不同应用领域对覆铜板性能的需求

应用领域	应用效果示意图	覆铜板性能需求偏好
手机		·智能手机:HDI 板,轻薄化、良好的刚性(超薄 PP),低膨胀系数、信号稳定性、高耐热、Low Dk & Low CTE(Anylayer),SLP; ·手机天线:载板(AiP)基材,耐 Package Assembly 条件、超低 CTE 以及 Low Dk;
通信基站		·SubG 基站天线:高频板,Dk 稳定、Low Df、厚度均一性好、耐 CAF; ·基站功放除上述要求外,还对热导率、尺寸稳定性及吸水率有严格要求; ·AAU-TRX 单元、BBU:高速板,Low Dk、Low Df、高耐热、耐 CAF、TCT、尺寸稳定性等; ·毫米波天线:高速板,Low DK、Low Df、一致性、高可靠性、尺寸稳定性、耐老化等;
网络设备		通信网络设备 (交换机/路由器/光模块等):高速板、Low Dk、Low Df、高耐热、耐 CAF、TCT、尺寸稳定性、适用于混压、HDI 制程需求等;
服务器		服务器:高速板、Low Dk、Low Df、同时超薄、高耐热、耐 CAF、TCT、尺寸稳定性、优异的性价比等;
计算机		·计算机主板部分: 一高性能:竞电、笔电等产品电性能向高速材料方向发展; 一超薄型:HDI 设计、良好的刚性(超薄 PP)及低膨胀系数要求; ·计算机显示部分(TFT LCD 为主):板材厚度均匀性、T1 等尺寸稳定性、优异的耐热性;
可穿戴设备		·可穿戴 Watch:载板 SiP(SLP)用基材,超小面积高层数(Anylayer)、耐 Package Assembly 条件、超低 CTE 以及超薄材料加工能力;
汽车		·传统汽车安全单元: 高可靠材料,可靠性强、耐热、耐湿、低膨胀、耐 CAF、TCT 等; ·新能源汽车: 智能液舱:FR4 及高速材料,HDI 制程、高可靠性; 智能电动:High Tg、高电压 CAF1000/1500V 及厚铜等; 智能网联:高速材料,low Dk/Df、高可靠性; 智能驾驶:高频板,Low Dk 和 Low Df 且稳定、板厚均匀、耐 CAF、加工性能好;
显示		·LED(大型显示器):Low CTE、高刚性和高平整度、可靠性强(耐冷热冲击)、厚度均匀、色泽一致性; ·LED(背光模组):高散热 & 高耐热板,优异的散热性 & 耐热性、高反射率等;载板基材(用于手机及平板等),除前述要求外,还需满足高刚性、高平整度; ·LED 驱动类:可靠性强、耐热、耐湿等;

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

自 2000 年设立以来,公司始终专注并深耕于覆铜板及粘结片业务,已形成自身独特的核心配方体系以及生产工艺体系,并围绕该些技术体系,形成了相关专利及非专利技术,能满足下游中、高端客户的严苛的技术要求。历经 20 余年的辛勤耕耘和自主创新,公司产品技术日益完善,业务品牌逐步做强,已逐步追上外资领先厂商的技术水准,在中高端产品上已实现了进口替代。近年来,随着 5G 建设的推进,公司在高速、高频等高端覆铜板产品领域重点投入、全面布局,是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业,产品性能与国际先进同行同类产品相比,水平相当或更为优异,已能实现进口替代。此外,公司完善了高频领域碳氢、PTFE 系列的产品。

公司在长期经营过程中形成了自身差异化的经营特色。凭借持续技术创新、出众的产品性能以及快速的服务响应,坚定走“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”市场营销策略,积累了奥士康、沪电、深南、景旺、胜宏、世运、健鼎等众多优质直接客户,并与华为、浪潮、三星、中兴等一大批知名终端客户保持密切的技术交流与合作。随着 N4 厂及 N5 厂全面投产,公司产能充足,具备各类产品尤其是高端覆铜板的批量稳定交付能力。据 Prismark 统计,公司 2021 年度全球覆铜板行业排名第九,全球市场份额占比为 4%。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)报告期内,受地缘政治、通胀等因素影响,全球 PCB 产业增速放缓。中长期内,亚洲仍将继续主导全球 PCB 产业,且仍以中国为主,利好内资覆铜板企业。

2022 年全球电子整机市场需求进一步下降,通讯、消费电子、能源、汽车等行业市场需求持续下滑。终端客户调整库存,减少供应,对 PCB 行业产生影响。据 Prismark 统计,预计 2022 年全球 PCB 产业总产值同比增长 2.9%,中国大陆同比增长 0.1%,而 2021 年全球同比增长 24.1%,中国大陆同比增长 25.7%,增速放缓。

另据 Prismark 统计,2021 年全球 PCB 产值 809.2 亿美元,亚洲占比 86.39%,中国占比 54.6%,2022 年预计全球 PCB 产值为 832.56 亿美元,亚洲占比 86.7%,其中中国占比 53.8%。预计到 2026 年,全球 PCB 产值预计将达到 1,015.59 亿美元,亚洲占比 85.61%,其中中国占比 53.8%。故中长期看,亚洲仍将主导 PCB 产业,且仍以中国为主,利好内资覆铜板企业。

(2)新产业蓬勃发展,带动高性能运算处理芯片、IC 载板、车载及数字能源的发展,给覆铜板产业带来了发展机遇。

① 半导体行业的快速发展,封装用 IC 载板作为集成电路主要承载材料,国产化替代将加速,从而推动 IC 载板材料的快速增长

近年来,国家相关部委出台一系列支持和引导半导体行业发展的政策法规,进一步鼓励国内半导体行业的发展。加之全球半导体景气度整体高涨,芯片需求激增的同时,我国 IC 载板市场及基材市场迎来了跨越式发展。

据 Prismark 数据显示,2022 年全球 IC 载板市场需求量 177.15 亿美元,较 2021 年增长了 22.9%,增速远高于整个 PCB 产业增速。此外 IC 载板市场在 2021-2026 年之间的复合年均增长率将达到 8.3%,是增长最为迅猛的细分市场。

另据 Prismark 报告分析,IC 载板应用大致可分为 WB PCBGA/CSP、FC PGA/LGA/BGA、FC CSP/FC-BOC 和 SIP/Module 四大块市场。该四大市场近两年营收及未来预测具体如下:

全球封装基板市场

单位:$M

类别	2020	2021	2022E	2026F	2022/2021	2021-2026 CAAGR
FC PGA/LGA/BGA	4,616	7,033	8,675	12,132	23.3%	11.5%
FC CSP/FC BOC	2,110	2,561	2,705	3,243	5.6%	4.8%
WB PBGA/CSP/BOC	2,194	3,032	3,116	3,297	2.8%	1.7%
SIP/Module	1,267	1,784	1,980	2,763	11.0%	9.1%
合计	10,188	14,410	16,476	21,435	14.3%	8.3%

其中 FCBGA 基板市场大,且应用最为重要及高端,主要应用于 CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA 以及 ADAS 等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI 等领域的需求激增,FCBGA 封装基板长期处于产能紧缺的状态,其必将带动 BT 板材和 ABF 等材料的需求。全球 FCBGA 主要供应商为日本揖斐电、欣兴电子、神钢电机、南亚、三星电机、大德等,均为日本、韩国、中国台湾等企业,几乎供应了全球 FCBGA 全部产值。中国大陆 FCBGA 封装基板领域还处于刚刚开始规划和投入,在国产化替代大背景下将有利促进国产 IC 载板及封装基材行业发展。

②汽车产业及汽车“新四化”的快速发展,驱动车用动力系统、智能驾驶辅助系统,智能电子系统、信息娱乐系统等所需车用电子的快速成长、拉动车用板需求增长

2022 年,我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆,同比增长 3.4%和 2.1%,全年实现小幅增长。我国汽车产销总量已连续 14 年居全球第一。2023 年,芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,随着相关配套政策措施的实施,国内汽车市场将呈现稳中向好的发展态势。

新能源汽车持续快速发展。中汽协数据显示,2022 年 12 月,新能源汽车产销分别完成 79.5 万辆和 81.4 万辆,同比均增长 51.8%,市场占有率达 到 31.8%。2022 年全年中国新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比增长 96.9%和 93.4%,市场占有率达到 25.6%,新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期。在新能源汽车主要品种中,与上年同期相比,纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。

随着汽车从传统意义上的机械产品逐步演化发展成为智能化、信息化、机电一体化的高技术产品,电子技术在汽车上的应用已十分广泛,无论是动力控制系统,还是安全控制系统、车身电子系统和娱乐通讯系统等都无一例外地采用了电子技术产品;得益于汽车电动化、智能化、无人驾驶等热点应用领域的带动,汽车电子产业蓬勃发展,推动了我国 PCB 市场规模持续增长。

此外新能源汽车基础设施建设也将逐步完善。高速公路快充网将加快构建,5G、智能交通等新型基础设施建设也在逐步部署并完善。这些均将为汽车电子带来全新的增量市场。

③ 环保及能源的可持续发要求推动光伏应用领域的快速发展,从而带动能源类材料巨大的发展空间

在“双碳”背景下,叠加地缘冲突带来的影响,凸显新能源对能源安全的重要性,光伏产业迎来巨大的市场发展空间。2021 年全球光伏装机量达到 843.1GW,预计 2023 年全球累计光伏装机量将达 1055.5GW,到 2030 年,光伏装机量将接近 5221GW,全球光伏发电量占总发电量约 19%;到 2050 年,光伏装机量将接近 14036GW,全球光伏发电量占总发电量约 29%。

光伏逆变器作为将光伏发电产生的直流电转化为交流电的电气设备,是光伏发电系统的关键设备之一。受益于光伏产业强劲发展势头,光伏逆变器市场也得以迅猛发展。近年来中国光伏逆变器国内企业全球市占率持续提升。2015 年以来,华为、阳光电源稳居全球逆变器行业前二,行业地位稳固;同时一大批国内知名逆变器品牌快速成长,出货量以及全球市占率稳步扩大。受益于光伏产业的大发展,又在国产化的大背景下,相关能源类覆铜板材料有望迎来巨大的增长空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,888,966,292.48	5,062,190,403.51	-3.42	3,622,841,543.23
归属于上市公司股东的净资产	2,676,838,558.26	2,893,849,389.09	-7.50	2,592,862,906.24
营业收入	3,778,211,331.21	4,207,119,601.56	-10.19	2,120,681,373.80
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,719,032,425.65	4,148,855,415.22	-10.36	2,090,252,290.15
归属于上市公司股东的净利润	44,885,188.36	399,326,612.90	-88.76	135,756,150.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,149,530.21	357,860,937.31	-106.19	104,246,849.76
经营活动产生的现金流量净额	285,355,029.35	48,587,615.48	487.30	-30,800,199.96
加权平均净资产收益率(%)	1.62	14.41	减少 12.79 个百分点	10.17
基本每股收益(元/股)	0.20	1.70	-88.24	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.20	1.70	-88.24	0.69
研发投入占营业收入的比例(%)	6.74	5.23	增加 1.51 个百分点	4.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	961,023,321.84	926,254,216.69	873,210,104.61	1,027,723,688.07
归属于上市公司股东的净利润	71,003,321.08	11,892,141.95	-28,835,558.78	-9,174,715.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,916,714.39	7,873,727.92	-37,024,562.67	-38,915,409.85
经营活动产生的现金流量净额	-58,410,051.90	172,776,448.94	9,268,390.07	161,720,242.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,299
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,516
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上海南亚科技集团有限公司	0	126,048,600	53.69	126,048,600	126,048,600	无	0	境内非国有法人
深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金	-20,434	12,409,845	5.29	0	0	无	0	其他
包秀银	0	8,755,543	3.73	8,755,543	8,755,543	无	0	境内自然人
包秀春	0	2,597,621	1.11	2,597,621	2,597,621	无	0	境内自然人
郑晓远	0	2,413,910	1.03	0	0	无	0	境内自然人
郑元超		1,889,918	0.81	0	0	无	0	境内自然人
光大富尊投资有限公司		1,840,490	0.78	0	0	无	0	国有法人
张东	-264,464	1,675,665	0.71	0	0	无	0	境内自然人
郑响微		1,637,800	0.70	0	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选证券投资基金		1,573,266	0.67	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东;包秀银、包秀春为一致行动人;郑响微、郑晓远为姐弟关系;张东为公司董事、核心技术人员;耿洪斌为公司董事。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688519　证券简称:南亚新材　公告编号:2023-012

南亚新材料科技股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,归属于公司股东的净利润为 44,885,188.36 元,公司期末可供分配利润为人民币 442,575,693.01 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 (含税)。截至 2023 年 3 月 9 日,公司总股本 234,751,600.00 股,扣除回购专用证券账户中股份总数 8,555,434.00 股后的股本 226,196,166.00 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 56,549,041.50 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 125.99%。

根据《上市公司股份回购规则》规定,“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 216,003,544.53 元 (不含交易费用),占归属于上市公司股东的净利润比例为 481.24%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因新增股份上市、回购股份等事项发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 3 月 21 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司经营现状和发展战略,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该利润分配方案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2023 年 3 月 21 日,公司召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为:2022 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司持续、健康、稳定的发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日

证券代码:688519　证券简称:南亚新材　公告编号:2023-014

南亚新材料科技股份有限公司 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 40 亿元。

● 本次授信不涉及担保事项。

● 本事项需提交股东大会审议。

2023 年 3 月 21 日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下:

根据公司 2023 年度的经营计划,为满足生产经营的资金需求,公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向中国进出口银行江西省分行等金融机构申请综合授信,额度不超过人民币 40 亿元的综合授信(以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准)。

上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。

为提高工作效率,及时办理融资业务,该议案经股东大会审议,股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,不再另行召开股东会会议。授权期限自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在授权期限内,授信额度可循环使用。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日

证券代码:688519　证券简称:南亚新材　公告编号:2023-017

南亚新材料科技股份有限公司 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)